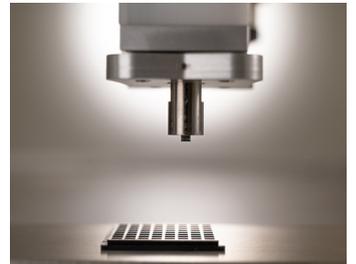
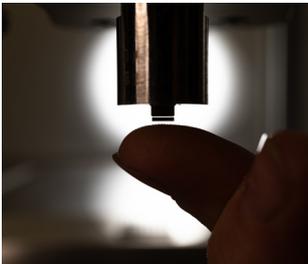


소형부품용 비접촉식 그리퍼



소형부품의 비접촉식 상부 그리핑 및 배치

소형부품용 비접촉식 그리퍼를 사용하면 민감한 재료를 비접촉으로 상부에서 선택적으로 들어올리거나 배치할 수 있습니다. 소형의 필름, 안경, 다이, 칩 및 렌즈와 같은 작은 부품을 취급하는데 사용됩니다.



진공과 초음파의 조합을 통해, 즉 흡입력과 반발력이 동시에 공작물에 작용하여, 위에서 들어 올리더라도 상호간격 간격을 유지하게 해 줍니다. 그 결과, 소형 부품에서는 어떠한 오염이나 미세 흠집이 발생할 수 없습니다.

소형부품용 비접촉식 그리퍼는 다양한 크기의 팁들과 결합할 수 있습니다. 치수가 작은 부품이기 때문에, 측면에 따로 보정지원(side-stopper)이 없이도, 부품이 자체적으로 척의 중심점으로 이동이 보장되며, 고정밀 위치제어가 가능합니다.

소형부품용 비접촉식 그리퍼의 특징:

- 비접촉식 상부 그리핑
- 공작물이 자체적으로 중심점으로 이동
- 고정밀 선택 및 배치
- 미세 흠집이나 기타 손상 없음
- 난기류에 의한 파티클 유입 없음
- 낮은 에너지소비량

응용



zs-handling.com

연락 및 영업

ZS-Handling GmbH
Budapester Straße 2
DE-93055 Regensburg

Phone: +49 941 60389-900
Fax: +49 941 60389-999
Mail: sales@zs-handling.de

자세한 내용은 왼쪽의 QR코드 및
<https://www.zs-handling.de>
웹사이트 참조하십시오



혁신적인 기술 : 초음파 서스펜션



당사의 핸들링 시스템은 공장물(기재)에 초음파 서스펜션 기술을 적용하여 핸들링하는 기술로, 모든 대기환경 공정에서 사용할 수 있습니다.

별도의 전력 제어 장치가 구비된 진동 발생기는 반발력으로 압축 공기 필름을 생성하며, 이를 통한 공정 조합을 통해 기재에 유인력을 부여할 수 있습니다.

주변 공기 또는 공정 가스는 초음파에 의해 압축됩니다. 이를 통해 부품을 비접촉식으로 정의된 경로를 따라 들어 올리고 안내할 수 있습니다. 부압과 함께 공작물을 건드리지 않고 윗면에 고정할 수도 있습니다.

초음파 서스펜션 기술은 다른 비접촉식 취급 기술보다 적은 에너지를 필요로 합니다.

ZS-Handling의 사명은 다음과 같습니다.

고객이 생산 및 테스트 목적으로, 민감한 제품을 비접촉으로 취급할 수 있도록 합니다.

우리는 비접촉 부상을 생성하는 부품을 제작하고 있습니다.

2006년부터 유럽, 북미 및 아시아 사용자를 위한 구성 요소 및 특수 기계를 개발, 생산 및 판매하고 있습니다.

제품군

- 비접촉식 태양광 그리퍼
- 비접촉 웨이퍼 그리퍼
- 미세부상 그리퍼
- 옵토 마이크로 메디 그리퍼
- 로봇 오버 헤드 그리퍼
- 초음파 비접촉 척(Chuck)
- 울트라 레비 데스크 (초음파 부상판)
- 비접촉부상 컨베이어
- 리니어 오버 헤드 운송 시스템
- 비접촉부상-검사-모듈
- 모듈식 웨이퍼 핸들링 시스템
- 부상Roll

한국일리스엔지니어링㈜
3층 및 5층 남도빌딩
용산구 장문로12 (동빙고동)
서울, 04393

전화 : +82 (2) 2276 0501-8
팩스 : +82 (2) 2272 9288
이메일 : seoul@illies.de

응용분야



- 배터리 및 연료 전지
- 포일(필름)
- 유리
- 렌즈
- 의료 기술
- 포장
- 웨이퍼 & 칩

적용공정



- 기판의 로딩과 언로딩 공정
- 운송공정
- 그리핑 공정
- 검사공정
- 분류 공정
- 분배 공정